經濟部
www.moea.gov.tw
新 聞 稿
NEWS LETTER
DATE 108.11.15

產業經濟統計簡訊《347》

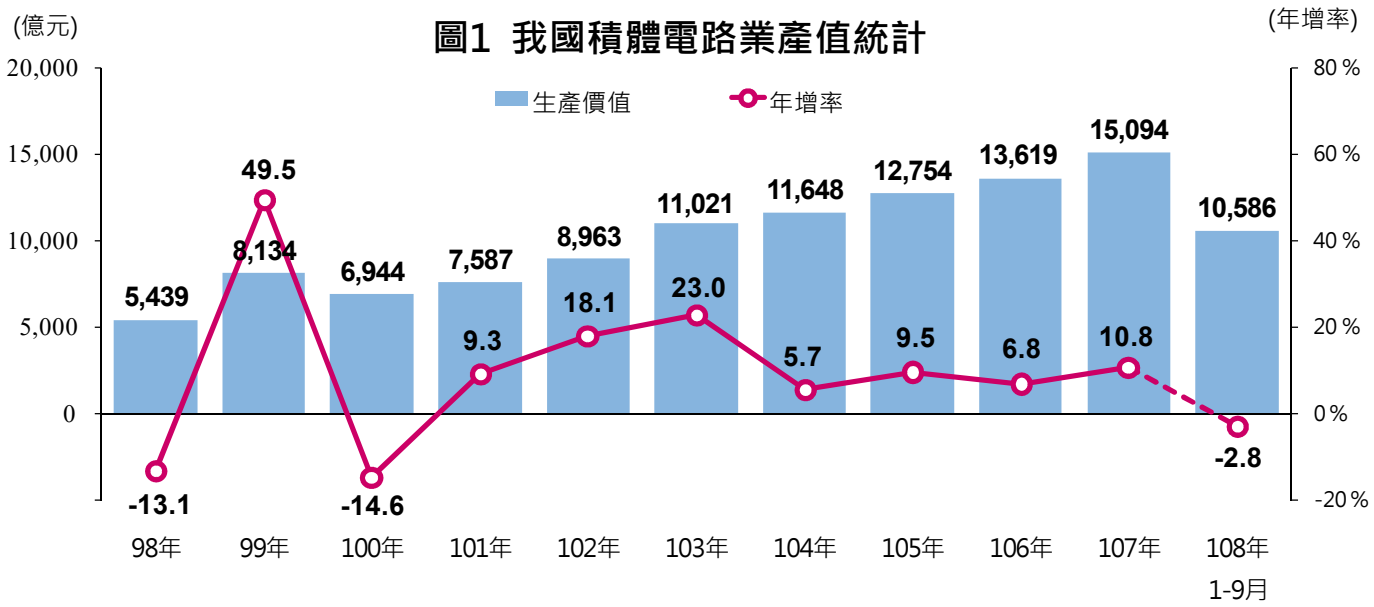
108 年積體電路業產值可望再創新高

1. **積體電路業近 6 年產值屢創新高：**隨著行動裝置推陳出新以及規格不斷提升，加上物聯網、車用電子、人工智慧等科技應用持續拓展，我國積體電路業憑藉優異製程技術，產值於 103 年首度突破兆元，並自 102 年起連續 6 年創新高。今年第 1 季由於智慧手機銷售疲弱加上虛擬貨幣採礦熱潮消退，產值年減 10.8%，第 2 季因終端電子產品需求仍弱，以及客戶端持續庫存調整，續呈年減 3.1%，惟第 3 季在各大品牌消費性電子新品陸續推出，以及 5G 基礎建設加速布建，帶動半導體高階製程需求強勁下，扭轉今年前兩季負成長態勢，年增 5.1%，累計今年前 3 季產值則年減 2.8%。

2. **晶圓代工為積體電路業成長之主力：**按產品產值結構觀察，晶圓代工產值約占積體電路業 8 成 3，DRAM 則約占 1 成。107 年晶圓代工產值達 1 兆 2,246 億元，連續 7 年創歷史新高，年增 6.4%，今年上半年雖受全球景氣影響而生產下滑，惟第 3 季起重拾動能，年增 12.1%；DRAM 及快閃記憶體因電子產品記憶體搭載容量不斷提升，加上固態硬碟應用普及，107 年產值皆創下歷史新高，分別年增 28.3%及 8.1%，惟今年則受價格滑落影響，1-9 月產值分別年減 19.3%及 21.1%。由於晶圓代工為積體電路業最主要之貢獻來源，今年下半年在我國晶圓代工恢復強勁成長下，可望彌補記憶體之減產空缺，有機會帶動積體電路業全年產值再創新高。

3. **積體電路出口市場以中國大陸及香港居冠：**我國積體電路業直接外銷比率約 8 成 4，108 年 1-10 月積體電路出口值達 756 億美元，較 107 年同期成長 3.8%，主要出口市場以中國大陸及香港(占 58.1%)為首，年增 5.7%，新加坡(占 12.8%)居次，年增 4.8%，日本(占 7.2%)及南韓(占 7.1%)再次之，出口值分別年增 11.7%及 0.9%。

4. **我國晶圓代工市占穩居全球第一：**根據 TrendForce 統計，108 年第 3 季全球晶圓代工廠營收排名，台積電市占率達 50.5%，穩居全球晶圓代工市場之龍頭寶座，聯電、世界先進、力積電亦名列全球晶圓代工前十大廠商，我國晶圓代工市占率合占達 59.8%，較第 1 季之 58.5%及第 2 季之 59.4%逐季提升。



資料來源：經濟部統計處

表1 我國積體電路業主要產品統計

統計期間	積體電路業產值(億元)			晶圓代工		DRAM		快閃記憶體	
		年增率(%)	直接外銷比率(%)		年增率(%)		年增率(%)		年增率(%)
103年	11,021	23.0	79.6	9,073	22.4	1,562	35.2	265	1.5
104年	11,648	5.7	83.2	9,900	9.1	1,365	-12.6	276	4.2
105年	12,754	9.5	81.4	11,094	12.1	1,254	-8.1	301	8.9
106年	13,619	6.8	84.6	11,507	3.7	1,492	19.0	419	39.1
107年	15,094	10.8	83.4	12,246	6.4	1,915	28.3	453	8.1
108年1-9月	10,586	-2.8	84.1	8,774	-0.2	1,169	-19.3	282	-21.1
第1季	3,195	-10.8	80.6	2,555	-12.9	395	-11.1	78	-36.0
第2季	3,431	-3.1	84.1	2,825	-0.2	383	-21.6	104	-18.9
第3季	3,960	5.1	86.9	3,393	12.1	391	-24.3	100	-6.9

資料來源：經濟部統計處。

表2 我國積體電路出口值-按地區分

單位：億美元

出口地區	103年	104年	105年	106年	107年	108年 1-10月
出口值	**661**	**637**	**723**	**858**	**884**	**756**
中國大陸及香港	334	310	392	467	505	439
新加坡	129	113	108	126	114	97
日本	39	53	55	58	60	54
南韓	65	72	65	67	63	54
年增率(%)	**13.8**	**-3.6**	**13.5**	**18.7**	**3.0**	**3.8**
中國大陸及香港	15.6	-7.2	26.4	19.2	8.2	5.7
新加坡	12.2	-12.9	-4.4	17.0	-9.5	4.8
日本	4.9	34.6	4.2	5.0	3.5	11.7
南韓	8.4	9.7	-9.7	2.8	-5.5	0.9
占比(%)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
中國大陸及香港	50.5	48.6	54.2	54.4	57.1	58.1
新加坡	19.5	17.7	14.9	14.7	12.9	12.8
日本	5.9	8.2	7.6	6.7	6.7	7.2
南韓	9.9	11.2	9.0	7.8	7.1	7.1

資料來源：財政部關務署。

附註：1.積體電路出口係以海關稅則號別8542節項下之商品出口值。

2.自我國出口積體電路(HS 8542)中，除含我國生產之積體電路外，尚包括進口加工品及封裝測試等價值，計算範圍與表1不同。

表3 全球前十大晶圓代工營收排名

單位：百萬美元；%

排名	公司名稱	108年 第3季營收	年增率 (%)	市占率(%) 108年 第1季	108年 第2季	108年 第3季
1	台積電(TSMC)	9,152	7.1	48.1	49.2	50.5
2	三星(Samsung)	3,352	3.3	19.1	18.0	18.5
3	格羅方德(Globalfoundries)	1,505	-6.3	8.4	8.7	8.3
4	聯電(UMC)	1,209	-6.5	7.2	7.5	6.7
5	中芯國際(SMIC)	799	-6.1	4.5	5.1	4.4
6	高塔半導體(TowerJazz)	312	-3.3	2.1	2.0	1.7
7	華虹半導體(Hua Hong)	238	-1.3	1.5	1.5	1.3
8	世界先進(VIS)	229	-10.1	1.5	1.4	1.3
9	力積電(PSC)	227	-33.4	1.7	1.3	1.3
10	東部高科(DB HiTek)	146	-8.7	0.9	0.9	0.8

資料來源：TrendForce

發言人：經濟部統計處　王副處長淑娟
聯絡電話：(02)23212200#8500
電子郵件信箱：scwang3@moea.gov.tw

業務聯絡人：經濟部統計處　周科長于晶
聯絡電話：(02)23212200#8503
電子郵件信箱：ycchou@moea.gov.tw

撰稿人：經濟部統計處　魏銘佑專員